

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2021-014

通富微电子股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事、监事、高级管理人员未提出异议：公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,323,116,836 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通富微电	股票代码	002156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋澍	丁燕	
办公地址	江苏省南通市崇川路 288 号	江苏省南通市崇川路 288 号	
电话	0513-85058919	0513-85058919	
电子信箱	tfme_stock@tfme.com	tfme_stock@tfme.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2020年，在集成电路国产化、智能化、5G、新基建等新兴应用的驱动下，集成电路行业景气度及市场需求逐季提升；受益于经济内循环和集成电路国产化浪潮，公司国内客户订单明显增加；国际大客户利用制程优势持续扩大市场占有率，订单需求增长强劲；海外大客户通讯产品需求旺盛，订单饱满；特别是第四季度，公司产能供不应求，产销两旺。公司通过精细化组织，做到“防控疫情、扩大生产”两不误，积极承接市场订单，扩大生产规模。2020年，公司实现营业收入107.69亿元，较上年同期增加30.27%，净利润38,851.05万元，同比增长937.62%。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	10,768,700,029.40	8,266,574,620.47	30.27%	7,222,862,993.75
归属于上市公司股东的净利润	338,427,876.25	19,141,404.20	1,668.04%	126,939,560.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,156,440.73	-130,404,521.14	258.86%	42,513,128.00
经营活动产生的现金流量净额	2,721,298,915.81	1,415,222,975.20	92.29%	752,859,484.21
基本每股收益（元/股）	0.29	0.02	1,350.00%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.02	1,350.00%	0.11
加权平均净资产收益率	4.96%	0.31%	4.65%	2.12%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	21,230,751,086.99	16,157,098,082.94	31.40%	13,968,377,342.51
归属于上市公司股东的净资产	9,578,582,586.37	6,110,947,111.94	56.74%	6,134,345,314.38

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,166,472,101.75	2,503,083,612.73	2,750,097,706.97	3,349,046,607.95
归属于上市公司股东的净利润	-11,728,287.22	123,173,307.50	150,365,349.19	76,617,506.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,808,150.19	59,008,948.63	125,656,458.00	56,299,184.29
经营活动产生的现金流量净额	127,852,034.91	620,044,533.94	470,805,809.03	1,502,596,537.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况**(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表**

单位：股

报告期末普通股股东总数	149,600	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	154,793	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
南通华达微电子集团股份有限公司	境内非国有法人	22.27%	296,041,893	0	质押	119,810,000	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	17.13%	227,663,017	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.81%	50,623,794	0			

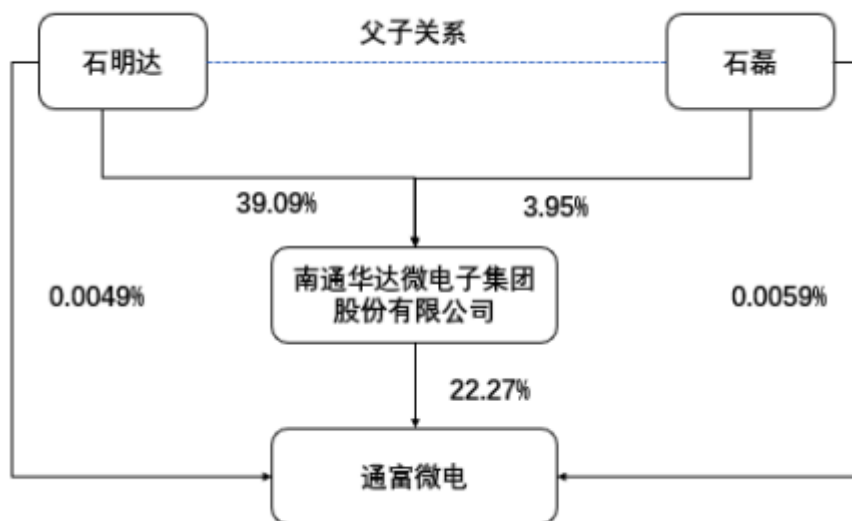
南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.99%	26,382,929	0	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.33%	17,627,562	17,394,962	
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.31%	17,368,846	0	
中金期货有限公司—中金期货—融汇1号资产管理计划	其他	1.21%	16,077,170	16,077,170	
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.76%	10,109,088	0	
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	8,569,660	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.64%	8,469,590	6,698,821	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，第1大股东与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	华达集团持股减少1,950万股，其中的1,150万股，系其通过中国证券金融股份有限公司证券转融通借出本公司股票所致，并非减持。				

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)概述

2020年，是公司历史上极不平凡、实现重大转折的一年，尽管受到疫情对市场冲击的影响，但公司全体员工积极响应政府号召，做到员工0感染的同时，为疫情期间保生产、疫情缓解后迅速扩产提供了有力保障。2020年，在集成电路国产化、智能化、5G、新基建等新兴应用的驱动下，集成电路行业景气度及市场需求逐季提升，特别是第四季度，公司产能供不应求，产销两旺。公司抓住我国集成电路大发展的机遇，充分发挥规模、技术优势，千方百计满足集成电路国产化的强劲需求，也使得公司得到高速发展。

1、狠抓市场开发，业务大幅增长

2020年，受益于集成电路国产化浪潮，智能化、5G、物联网、电动汽车等新技术的落地应用，集成电路行业景气度及市场需求逐季提升；此外，疫情催生下的“宅经济”也带来NB、PC、服务器、电玩等电子终端需求大增。在此背景下，公司利用先进制程制造优势，夯实与国际客户的战略合作；同时，公司牢牢抓住经济内循环和集成电路国产化浪潮带来的机会，紧紧围绕4G&5G手机市场、WIFI/蓝牙连接、存储器、显示驱动IC等国产替代带来的机遇，通过不断投入和丰富产品线，获得更多市场机会；加强和细分领域的头部企业战略合作，资源聚焦与优化，提升客户端的市场占有率。2020年，公司实现营业收入107.69亿元，较上年同期增加30.27%，营收规模继续排名全球封测企业前列；总资产达到212.31亿元，同比增长31.40%。

2020年，公司立足7nm，进阶5nm，全力支持AMD的高速发展，其产品在本笔记本、服务器、显卡、游戏机多点开花，其他客户的产品也在高速健康的成长。同时公司深入开展5nm新品研发，将助力CPU客户高端进阶。2020年，通富超威苏州、通富超威槟城合计实现营收59.55亿元，同比增长37.55%，利润同比实现翻番，取得了并购后的最佳经营年度业绩。

2020年，公司前期布局的各项新业务进展顺利：存储器产品封测和显示驱动芯片封测均已实现量产，这两块业务均有巨大的国产替代空间，今后有望爆发式增长。

2、技术研发突破，持续提升产品技术水平

2020年，公司的产品研发和技术创新取得新成果：

- (1) HPC（高性能计算）：2.5D封装技术研发取得新进展，打通了2.5D工艺研发全流程；
- (2) SiP\SLI（系统集成）：建成设计仿真平台，设计出了多个系统级封装解决方案，与国内一流设计公司合作开发穿

戴式、5G wifi、TWS等先进封装SiP产品；

(3) Memory（存储领域）：Memory产品技术能力明显增强，在先进封装未来发展技术关键节点与客户深入合作，合肥工厂快速进入量产并实现营收和盈利的突破；

(4) DD（显示驱动）：完成OLED/无边框面板所需COP工艺开发，是首家实现金凸块封测量的国内封测企业；

(5) 车用功率器件：在大功率SOP模块、高温无铅熔扩装片等方面取得重大突破，巩固了公司在国内车用功率器件OSAT领军企业的地位；

(6) Fanout封装技术实现在CIS、压力传感器、光电心率传感器等多个领域应用，Fanout线FOPoS技术Fanout+FCBGA创下多个国内第一，部分产品开始量产。

截止2020年12月31日，公司累计申请专利达1,080件，获专利授权（有效）519件，其中发明专利占比55%，蝉联中国专利优秀奖。申报公司级科技进步奖项目64个，入围35个，公司“大尺寸芯片基板扇出封装”项目荣获科技进步一等奖。同时，公司“国产CPU封装测试全制程量产成套工艺成果转化项目”获评2020年度中国集成电路创新联盟IC创新奖之成果转化奖，成为封测领域唯一获此殊荣的企业。

3、重大工程项目进展顺利，助力企业更快发展

2020年，苏通工厂二期工程项目、合肥工厂二层DRAM项目、厦门工厂一期厂房投入使用，新投入使用厂房建筑面积达11.6万平米，2万余平米的崇川工厂车载品智能封装测试中心厂房完成土建工程正在净化安装中，以满足公司整体生产运营的迫切需要。

4、获得多家客户褒奖，政府补助助力公司发展

公司荣获“长鑫存储卓越技术合作奖”、“华虹集团开放创新合作奖”、“艾为最佳供应商奖”、“卓胜微2020年战略供应商”等奖项，在客户层面的口碑和满意度全面提升。

2020年，公司完成国家、省市区各级政府项目申报、检查及验收超100项；2020年，到账政府项目补助资金超1亿元，有力的支持了公司发展。

5、人才培养体系化、专业化

2020年，公司成立了通富学院，根据不同的人员层次和培养方向，分别开设了领航班、腾飞班、起航班，组织公司资深专家和外部机构，对学员授课，人才培养走向体系化、专业化。此外，公司与地方大学联合开课，40余人学历获得提升。

6、融资促发展，激励增士气

为促进公司健康长远稳定发展，2020年，公司组织实施了非公开发行股票工作，2020年11月24日，公司非公开发行的175,332,356股在深交所上市，募集资金总额达32.72亿元人民币，为公司发展及产能扩张，提供了有力的资金保障。

2020年12月26日，公司披露了《第一期员工持股计划》。本次实施员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，提升公司的吸引力和凝聚力，进而提升公司核心竞争能力，促进公司持续、健康、高效发展。

(二)公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业发展趋势

1、我国半导体产业将快速发展，国产替代仍旧是2021年的半导体产业发展主线，产能紧张的矛盾依然突出

2020年，受新冠疫情影响全球经济出现了衰退。中国及时控制疫情，使经济逆势增长，2020年中国GDP首次突破100万亿大关。在中国经济增长的带动下，中国集成电路产业继续保持快速增长态势。中国半导体行业协会公布数据显示，2020年中国集成电路产业销售收入达8848亿元，较2019年增长17.0%。其中，2020年中国集成电路封测业销售收入为2509.5亿元，同比增长6.8%。

2021年，半导体国产化的浪潮继续汹涌澎湃，并且会加速在重点产品领域和基础环节的上下游产业链协同发展。国内5G、新能源汽车等新基建市场将会进一步提升渗透率，带动国内半导体产业在通信及射频器件、消费电子、功率半导体、汽车半导体等方面加速发展。

此外，政府文件中明确提出：我国目前芯片自给率仅为30%，目标在未来五年内自给率要达到70%。这使得国产替代还有极大的上升空间，尤其是在CPU、存储器等高端芯片方面。

基于上述分析，国内半导体2021全年预计实现20%以上增速，整体产业规模有望超过万亿元。

市场的巨大需求导致半导体供应链和产能紧缺，该矛盾短期内难以解决。目前来看，半导体产业处于高景气周期，产能供给紧张带来的缺货、涨价情况已遍布行业内很多环节，从设计到晶圆到封测，都与客户协商调涨价格。半导体产能紧张的局面还会在相当长的一段时间内延续。

2、全球半导体走势

IMF对世界经济展望给出的最新预测是2021年全球经济增长5.2%，这对全球半导体行业而言无疑是一个乐观的指向。Gartner对于2021年的半导体行业给出了接近10%的增长预期，WSTS给出了6.2%的增速判断。目前全行业开始朝向稳健复苏成长的态势发展，在汽车、5G通信、数据中心等关键市场上，已经表现出了比较明确的快速增长迹象。对于全球半导体产业而言，2021年还会是一个值得期待的景气年份。

3、终端市场发展方面

(1) 高性能运算爆发，大数据中心需求有望大涨

2020年受宅经济的影响，云计算、大数据中心成为半导体产业主要的应用市场之一。根据Gartner数据统计及预测，2020年，全球云计算市场规模超过2200亿美元。由此将对半导体产品形成巨大的采购需求。这种需求将延续下去，预计至2023年市场规模将会达到约3600亿美元。

更加值得注意的是，人工智能与云计算大数据中心的融合正在深化。人工智能高性能计算机群(AI-ForceHPC)市场的发展成为新的亮点。Tractica预测，人工智能高性能计算机群将是服务器市场继传统HPC后新的增长动力，2020年约有187亿美元的市场规模，至2025年将达到205亿美元，同时预计2021年至2025年CPU和服务器在高性能运算芯片的需求占比中将超越智能手机提升至第一位，相关品类的芯片有望受到需求拉动迎来持续高景气。

(2) 5G加持智能手机市场将全面复苏

多年来，智能手机一向是拉动半导体产业发展的主流应用，2021年，随着各国陆续恢复5G建设，移动处理器大厂也相继推出中低阶5G芯片，预估全球5G智能手机生产总量约5亿部，渗透率将快速提升至37%，在5G的推动下，智能手机或将出现全面复苏。5G的应用也在不断扩展，各种垂直行业的应用不断被开发出来。赛迪顾问在报告中指出，5G通信技术是全球半导体重要驱动因素。随着5G各类应用的充分挖掘，应用场景不断落地，5G应用终端在未来3至5年都将持续放量。

(3) 随着5G、物联网技术的赋能，存储器芯片市场规模将进一步扩大

由于当前存储器芯片应用广泛，同时下游消费电子市场份额逐年扩大，且未来5G及物联网技术将进一步为中国存储器芯片的整体发展赋能，预计未来中国存储器芯片还将继续保持稳定增长的态势。到2024年，中国存储器芯片市场份额有望突破522.6亿美元，占全球市场的14%。

目前存储器国产化率很低，急需发展自主可控的存储器产业链。因此，存储器国产化的市场空间巨大、前景明朗。

(4) 显示驱动芯片持续增长，国产替代空间巨大

统计数据显示，2019年全球显示驱动芯片出货量由2012年的88.4亿颗上升至156.0亿颗，年复合增长率达到8.4%。未来，显示技术的升级与下游应用的拓展将推动显示驱动芯片市场的进一步增长，2024年全球出货量预计将达到218.3亿颗，至2024年的年均复合增长率为7.0%。

国内面板产业已全球第一，但显示驱动芯片自给率不足5%，急需大力提升，在此显示驱动领域拥有巨大的国产替代空间，国内产业链相关公司预计会实现爆发式增长。

(5) 新能源汽车逆势上扬，车用半导体需求将大增

中国汽车工业协会数据显示，2020年汽车销售2531.1万辆，虽然同比下降了1.9%，但销售情况却好于预期，销量继续蝉联全球第一，预计2021年将实现恢复性正增长，汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%左右。2020年，新能源汽车市场逆势上扬，成为首个销量同比实现正增长的汽车细分市场。2021年，新能源汽车销量增速很可能超过30%，达到180万辆。汽车行业正在经历历史性的变革，智能化、电动化、网联化已经成为汽车产业不可逆转的趋势。这些需求驱动着2021年车用半导体市场的发展。拓璞产业研究院预估，2020年全球车用芯片产值可达186.7亿美元，2021年将达到210亿美元，年增长率12.5%。

4、新政策进入落地阶段

2020年集成电路产业新8号文发布，按照时间进度2021年将出台实施细则，明确政策实施标准和条件、实施方式等，全面进入政策落地阶段。2021年还会实质性推进集成电路一级学科建设，加速深化集成电路人才培养改革，会有更多高校分批获准建设国家集成电路产教融合创新平台，同时更多企业会加大与高校院所在产教融合人才培养及产学研方面的合作。大基金二期在2020年主要投向代工和存储器制造，设计方面的投资标主要集中在上海、北京等一线城市，预计在2021年会加快覆盖更多地域和更多产业链环节上的投资，地域上增加中西部和珠三角地区的投资，产业链环节上会投资到半导体设备、材料及EDA等基础支撑环节。

综上所述，受益于集成电路国产化浪潮，智能化、5G、物联网、电动汽车等新技术的落地应用，整个行业处于高景气周期，终端市场需求将持续增长，产能紧张的局面还会持续相当长的时间。2020年以来，国家支持集成电路产业发展的政策红利正在逐步释放，集成电路国产化需求大大提升，国产化的强劲需求有力的推动了行业快速发展，国内封测企业也迎来了前所未有的发展机遇。这些都为公司的大发展创造了极为有利的条件。

(2) 公司发展战略及规划**1、公司发展战略**

公司紧跟市场与客户需求，注重质量，加快发展，继续做大做强。公司总体战略为“立足本地、异地布局、兼并重组，加快发展成为世界级封测企业”。公司坚持聚焦主业的发展战略，通过并购通富超威苏州和通富超威槟城，公司与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式，进一步增强了公司在客户群体上的优势；公司坚持科技创新的发展理念，引进国内外高层次人才，不断推出满足市场需求、高科技、高附加值的产品，使公司产品技术始终保持国内领先、国际一流水平；在科技创新引领下，公司建立了高端处理器、存储器、显示驱动芯片封测基地，为这些高端产品的国产化提供了有力支撑，同时，国产化的巨大需求又给公司提供了发展良机；公司坚持“以人为本、产业报国、传承文明、追求高远”的企业使命，始终以为股东、为客户、为员工、为社会创造价值为己任，促进公司与社会的和谐发展；公司抓住目前集成电路发展的大好时机，利用国家对集成电路行业的高度重视和强力扶持，积极承担国家科技重大专项等项目，在先进封装技术研发与应用、知识产权方面取得重大突破和创新，力争成为世界级封测企业，努力使排名不断向前。

2、公司业务发展趋势

受益于集成电路国产化浪潮，智能化、5G、物联网、电动汽车等新技术的落地应用，2021年中国集成电路产业规模将进一步扩大。公司将持续服务好现有大客户，包括：CPU国际大客户、手机海内外大客户等，最大程度配合国内集成电路市

场需求的急剧上升，在国内接近空白的存储器、面板显示用芯片等业务领域持续发力，充分发挥现有优势，在2020年营收107.69亿元，同比上年增长30.27%的基础上，2021年继续保持营收大幅增长。对照上述5个快速发展的终端市场，公司均有相应布局，并取得了较大优势：

高性能计算方面，得益于“先进架构”叠加“先进工艺”，公司战略合作伙伴AMD在2020年取得重大进展，成为高性能计算领域的领导者，成功量产超过20种7纳米制程的PC、游戏和数据中心产品，全年营收增长45%，创97.6亿美元的新纪录，毛利率也连续第五年增长，预计2021年全年营收增长约37%，未来仍将高速增长。公司下属子公司通富超威苏州、通富超威槟城作为AMD最主要的封测供应商，其业务规模也将呈现高速增长。

5G方面，公司另一大客户联发科借助于5G手机、5G网络连接设备、智能电视、智能语音及可穿戴设备等业务的快速增长，其2021年1月和2月的营收同比增长78.4%，发展势头非常强劲。公司作为联发科在中国大陆重要的封测供应商，与联发科的业务规模也会大幅增长。除联发科外，紫光展锐、卓胜微、汇顶科技、圣邦、矽力杰、艾为等国内其他与5G、物联网产业相关的客户也是多点开花，订单需求十分旺盛。

公司经营层始终关注存储器、面板显示用芯片这两类国内接近空白的“大宗物资”的业务机会，很早就开始相关产品的研发布局和产业化投资。目前，在存储器、显示驱动芯片业务中，公司均处于国内第一方队，与国内行业龙头企业保持紧密合作，先发优势明显。

存储器方面，公司与国内存储芯片制造企业高度合作，在DRAM和NAND方面均有布局，产品覆盖PC端、移动端及服务器。经过前期的投入和布局，现在已逐步进入收获期：DRAM产品在2020年已开始量产，预计2021年的业务规模将快速提升；NAND产品已通过考核，进入量产阶段。

显示驱动芯片方面，国内面板产业已全球第一，但显示驱动芯片自给率不足5%，拥有巨大的国产替代空间。公司不断投入资金、设备、人才、研发力量，目前已导入海外及国内第一梯队的显示驱动芯片客户，预计相关业务2021年会有不俗表现。

汽车电子方面，公司在汽车电子领域布局多年，已通过了IATF16949体系认证，积累了NXP、英飞凌等优质的汽车电子客户，可以在车用半导体需求大增的背景下，发挥既有优势，进一步扩大汽车电子业务规模，助力中国电动汽车行业实现弯道超车。

目前，半导体封测产能出现了长时间供不应求的局面，公司可以利用这个时机同客户一起沟通、协商，调整成本结构和价格，提升产能利用效率。一方面带动公司盈利能力回升，另一方面，实现公司和客户的良性可持续发展。

综上，公司2021年业务发展趋势良好，我们将紧紧盯住2021年营收目标不放松，寻找机会，实现公司更大的发展。

3、公司2021年度经营目标

在2020年营收107.69亿元，同比2019年增长30.27%的基础上，公司计划2021年实现营业收入148.00亿元，较2020年实绩增长37.43%，预计经济效益也将实现飞跃式增长。该生产经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司经营等多种因素，存在一定的不确定性。

2021年是国家“十四五”规划起始之年，国家把关键核心技术实现重大突破摆在重要位置，公司正处于战略机遇叠加期，政策红利释放期，将重点开展以下几项工作：

（1）聚焦销售业务和高端封测，确保订单增长

随着智能化、5G、IOT、数据中心等市场的成熟，2.5D/3DTSV技术、Fanout技术、SLI等主流先进封装技术的市场规模将保持增长。公司将继续积极布局Fanout、2.5D、SiP、存储、显示驱动、汽车电子等高端封测，渗透新兴领域与客户群体，为公司持续高速高效发展打下市场基础。同时，夯实公司在CPU客户No.1的供应链地位，继续提升各大客户的销售份额。

（2）聚焦运营管理，促进效益提升

培养精英团队、核心骨干，重点提升工程技术人员工程能力，进一步提升设备有效利用率；加速推进智能制造CIM，大幅提高人均产出。

（3）聚焦以人为本，增强队伍合力

建立公司COE、SSC、HRBP三支柱，建设精兵强将高绩效团队，以提升人均效率、人均效益为目标。公司重视人才的培养，导入行动学习等高效学习培训方法，调动员工智慧，通过成立“通富学院”以及联合地方大学，有计划地进行储备干部的培训培养；通过实施员工持股计划更有力的调动团队积极性。

4、为实现公司发展战略的资金需求及使用计划

为实现上述经营目标，并为今后的生产经营做适当准备，公司及下属控制企业南通通富、合肥通富、通富超威苏州及通富超威槟城计划2021年在设施建设、生产设备、IT、技术研发等方面投资共计48亿元。

公司与合肥政府、厦门政府建立了合作关系，合肥通富获出资12亿元，厦门通富注册资本8亿元全部出资到位；南通通富获得1.56亿国家专项建设基金支持；收购通富超威苏州及通富超威槟城各85%的股份获得产业基金2.7亿多美金的支持；公司与商业银行及政策性银行均保持长期密切合作；2020年公司开展了非公开发行募资工作，募集资金总额达32.72亿元人民币，将为公司技术升级、扩大生产规模、优化产品结构、增强竞争优势，奠定了坚实的资金基础。

（3）公司的风险因素及应对措施

1、行业与市场波动的风险

全球半导体行业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点，半导体行业与市场的波动会对公司的经营业绩产生一定影响。同时，受国内外政治、经济因素影响，如市场需求低迷、产品竞争激烈，将会影响产品价格，对公司的经营业绩产生一定影响。公司将密切关注市场需求动向，积极进行产品结构调整，加快技术创新步伐，降低行业与市场波动给公司带来的经营风险。

2、新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险

目前新兴产业、智能产业的发展对集成电路产品的要求越来越高。公司通过承担国家“02”专项、收购AMD封测资产，已经取得一定的科研成果，已经具备了提供大规模先进封测的能力。同时，公司大部分产品技术比较成熟，具备丰富生产经验，但个别的新技术、新工艺、新产品在产业化过程中，如出现一些波折或反复，将给公司生产经营造成一定影响。对此，公司通过引进高层次研发人才、并购高端封测资产，主攻技术含量高、市场需求大的新产品，努力在技术研发层面上少走弯路；公司核心技术骨干和管理力量也将优先服务于新技术、新工艺、新产品，配合客户做好产品认证工作，提前预测产业化过程中有可能出现的问题，做好对策分析工作，缩短客户认证时间，确保新产品如期产业化。

3、原材料供应及价格变动风险

公司封装测试所需主要原材料为引线框架/基板、键合丝和塑封料。公司主要原材料国内均有供应，公司有稳定的供应渠道。但公司外销业务比例较高，境外客户对封装的无铅化和产品质量要求较高，用于高端封装产品的主要原材料必须依赖进口。因此，不排除中国原材料市场供求关系发生变化，造成原材料价格上涨，以及因供货商供货不足、原材料涨价或质量问题等不可测因素，或者境外原材料市场发生变化，影响公司的产品产量和质量，对公司经营业绩产生一定影响。

4、外汇风险

2018年、2019年及2020年，公司出口销售收入占比分别为86.41%、81.27%、79.05%，以外币结算收入占比较高。如果人民币对美元汇率大幅度波动，将直接影响公司的出口收入和进口成本，并使外币资产和外币负债产生汇兑损益，对公司业绩产生一定影响。

5、重大突发公共卫生事件的风险

新冠肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，国家及各级政府均采取了延迟复工等措施阻止疫情进一步蔓延，对公司的生产经营活动造成了一定短期影响。目前，随着国内疫情得到有效控制，生产和物流逐步恢复，公司各项生产经营工作有序开展，新冠疫情对公司的不利影响已逐步消除。未来若全球疫情未来无法得到有效控制，各国政府将可能出台进一步控制疫情的措施，届时全球化半导体产业链的稳定运营可能面临重大挑战，进而对公司未来生产活动和经营业绩造成不利影响。公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

6、国际贸易风险

公司作为半导体封测代工企业，从产业链角度受中美贸易争端影响较小，且报告期内公司自中国大陆直接出口至美国的业务收入及占比较小，但是中美贸易摩擦可能通过影响公司客户备货情绪进而间接影响公司的经营活动，可能对公司未来的经营业绩带来一定的不利影响。公司将及时跟进中美贸易争端进展并披露相关信息，并将积极采取应对措施，尽可能地降低国际贸易带来的风险。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
集成电路封装测试	10,535,668,984.14	276,937,284.87	15.01%	29.88%	329.64%	2.31%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

2020年，公司实现营业收入107.69亿元，较上年同期增加30.27%；营业成本91.03亿元,同比增长27.55%；归属于母公司股东的净利润3.38亿元，同比增长1668.04%。主要变化原因详见本摘要二、公司基本情况 2、报告期主要业务或产品简介。

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

①新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第六届董事会第十八次会议决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

②企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

通富微电子股份有限公司

董事长：石明达

2021年3月29日